

# 苏州国芯科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

### (2023 年半年度业绩说明会)

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2023-016

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 9 月 28 日 13:00 至 14:00
地点	线上交流
上市公司参加人员姓名	董事长：郑荏先生； 董事、总经理：肖佐楠先生； 董事会秘书：黄涛先生； 财务总监：张海滨先生； 独立董事：张薇女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2023 年 9 月 28 日 13:00 至 14:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：<a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a>）召开了 2023 年半年度业绩说明会。公司董事长郑荏先生首先致词，向广大投资者报告了公司 2023 年半年度经营情况。随后，公司管理层与投资者进行了线上交流。主要内容如下：</p> <p><b>1、肖总您好，请问公司的在手订单情况是怎样的？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 6 月 30 日，公司的在手订单金额为 5.43 亿元。按照应用领域来划分，汽车电子和工业控制业务的在手订单金额为 0.73 亿元，信创和信息安全业务的在手订单金额为 0.57 亿元，边缘计算（高性能计算）和人工智能业务的在手订单为 4.13 亿元。下半年，公司会继续开拓新的订单，并加强在手订单的执行工作，做好技术支持服务和产能</p>

的保障工作，尽最大努力促进业务推进。谢谢！

## 2、边缘计算芯片业务的发展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司在边缘计算领域的业务包括自主芯片和定制服务两个方面，2022年边缘和高性能计算领域实现销售收入1.21亿元，与2021年相比增长71.41%；2023年上半年实现边缘和高性能计算领域销售收入1.11亿元，与上年同期相比增长104.39%。截至2023年6月30日，公司的边缘计算（高性能计算）和人工智能业务的在手订单为4.13亿元，这对于公司未来该项收入的增长提供了较好的支撑。公司研发的自主边缘计算芯片具备多核计算、网络路径和协议加速引擎、路由转发以及多种高速通信接口，适用于边缘计算与网络通信领域产品的计算、安全及通信需求。高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制器芯片H2040，基于28nm工艺设计，采用国芯32位四核的PowerPC指令架构CPU核，集成DDR3.0、PCIe3.0、千兆网、SATA2.0、RapidIO2.0等接口。高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制芯片CCP1080T，基于14nm工艺设计，采用国芯64位多核PowerPC架构CPU核，集成高性能密码算法引擎、网络数据加速引擎等，具有万兆网、PCIe3.0、USB3.0等高速接口。上述二款芯片均已完成芯片测试，功能和性能指标满足设计需求，进入市场推广。谢谢！

## 3、领导好，请问 Raid 控制芯片业务的进展怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司于今年上半年成功研发 Raid 控制芯片 CCRD3316，该芯片是在原有第一代 Raid 控制芯片客户验证和使用反馈的基础上，进行完善和优化设计的改进量产版产品。相比原产品，该改进版本支持独立 SATA3.0 接口达到 16 个，DDR 性能频率提升至最高可达 1600MHz，优化并增加 Raid 算法引擎达 4 组，增强了应对异常处理的掉电保护和恢复机制，同时对硬盘硬件兼容性进行了改善。该产品上行接口兼容 PCIE3.0 标准，实现数据的高可靠、高效率存储及传输，为客户提供灵活可靠、大容量存储资源。基于该款芯片产品开发的阵列卡存储扩展系统具有以下特点：基于高性能国产 C\*Core C8000 CPU，具有较强的数据处理能力；全面的 Raid 数据保护机制，提供 RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD 模式；支持掉电保护和恢复功能；适配国产阵列管理软件。CCRD3316 的性能与 LSI 的 9361 系列相当，可实现

同类产品的国产化替代,打破长期以来 Raid 控制芯片被国外公司垄断的局面。

磁盘冗余阵列目前重要的功能在于,当阵列中任意一个硬盘发生故障时,仍可读出数据,在数据重构时,可将经计算后的数据重新置入新硬盘中。Raid 控制芯片及阵列卡存储系统面向服务器和信创存储设备应用,支持机械硬盘或 SSD 固态存储盘,对于重要数据起到了保护和恢复作用,在 AI 服务器、存储服务器和信创存储设备等领域有广泛的应用。

在 CCRD3316 内部测试成功基础上,根据市场反馈,公司积极完善 Raid 卡方案,加强技术支持服务团队,相关 Raid 卡方案已经在多家重点客户进行产品应用测试,未来将进一步拓展到更多的应用厂商。

同时,公司正在基于自主高性能 RISC-V CPU 研制开发第二代更高性能的 Raid 芯片,目前各项工作进展顺利,未来有望达到国际主流 Raid 芯片的性能。Raid 芯片是服务器中广泛应用的一个重要芯片产品,长期以来被国外公司垄断,急需实现国产化替代。谢谢!

**4、您好,汽车点火芯片验证情况,今年能获得订单吗?**

答:尊敬的投资者,您好!公司汽车安全气囊点火芯片已经内测成功,目前正在多家重点客户进行台架实验,预计今年有望实现装车使用和量产。该安全气囊点火芯片打破了国外公司对中国的垄断,填补了国内空白,受到客户的欢迎。谢谢!

**5、三季报会有业绩预告吗?公司如果不再回购股份,能否发公告果断终止?**

答:尊敬的投资者,您好!公司三季报将于 2023 年 10 月 28 日披露,公司股份回购正在实施过程中,详细情况请以公司披露的临时公告为准,谢谢!

**6、尊敬的董事长您好。请问公司在汽车电子芯片领域,有没有向智能驾驶 SOS、智能座舱 SOC 领域拓展的规划;请问在边缘计算和通讯领域,自主芯片(模组)业务和定制业务,中远期收入占比分别为多少;在信息安全领域,公司的发展似乎遇到瓶颈,请问如何破解;J 建议公司在季度报告、年度报告披露在手订单等信息。谢谢。**

答:尊敬的投资者,您好!公司目前在汽车电子芯片领域已经进行了 12 条产品线布局。同时,公司与昆仑芯(北京)科技有限公司已经签署《战略

合作框架协议》，双方将针对智能驾驶场景，展开在边缘 AI 计算、车规功能安全 SoC 等技术领域的长期合作，充分整合双方资源，实现优势互补，协同提升技术竞争力，共同开拓更加广阔的智能驾驶市场。在边缘计算领域，自主芯片（模组）业务和定制业务将同时推进，近阶段以定制芯片业务为主，未来希望能更多地实现自主芯片业务。在信息安全领域，上半年受宏观环境等各方面因素的影响，收入有所下降，但是信息安全产业仍然是未来有较大发展前景的领域，仍然是公司的重要发展方向，公司在信息安全产品方面会继续进行投入，为未来业绩发展奠定基础。您的建议我们已经收到，我们将充分考虑和汲取，谢谢！

7、（1）请问公司上半年 5.43 亿元的在手订单，今年能全部转化为收入吗？（2）今年三、四季度代工成本会下降吗？公司三、四季度毛利率是否会提升？（3）公司第三季度汽车订单是否回暖？车企去库存是否改善？（4）公司是否考虑并购 GPU 公司等措施，加快 AI 相关芯片的研发与市场拓展？（5）公司对今年利润同比增长是否有信心？以回报股东。烦请逐一详细些回答，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！1、根据合同约定，截至 2023 年 6 月 30 日 5.43 亿元的在手订单大都需要在 2023 年完成，公司将加强内部的精细化管理，积极推进在手订单执行工作，继续着力攻坚头部重点客户、重点项目，尽可能实现项目的快速量产和订单的执行，尽最大努力回馈广大投资者；2、公司晶圆代工成本今年二季度以来相对稳定，二季度毛利率比一季度略有上升，三季度以来晶圆代工成本略有下降。后续公司将在扩大市场的同时，采取积极措施维护好产品毛利水平。3、汽车产业芯片去库存还在继续，公司一方面密切关注市场的变化，积极加大研发投入，提升核心竞争力，重点发展国内尚属空白的芯片产品，进一步提升单颗芯片价值；另一方面继续着力攻坚头部重点客户、重点项目，尽可能实现项目的快速量产；4、公司暂未考虑并购 GPU 公司，但公司正在和参股公司智绘微电子合作，联合投资和开发 GPU 芯片，公司主要从事后端设计和流片工作，该 GPU 芯片已完成设计，目前正在流片验证中，未来将以国芯科技和智绘微双品牌进行市场销售。同时公司和上海清华国际创新中心、智绘微电子合作开发基于开源 RISC-V 架构的

GPGPU 内核，为公司未来发展打下技术基础；5、公司目前在手订单充沛，边缘计算业务发展迅速，全年业绩情况请以公司披露的定期报告为准，公司目前处在成长期，各项业务的发展和业绩的实现需要一定的时间，公司致力于回馈广大投资者，我们对公司未来的发展有充足的信心，感谢投资者对公司的支持和关心。谢谢！

**8、公司股价跌跌不休，业绩亏损，负增长，请问公司有什么举措实现今年业绩的正增长？公司有信心以好的业绩回报投资者吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司股价近期波动受二级市场行情等多种因素综合所致，公司经营管理一切正常并持续向好，公司的投资价值未发生重大变化。公司半年度业绩发生亏损的重要原因是大幅度地加大了研发投入，研发工作的加强将为未来公司汽车电子、边缘计算和服务器存储控制等重点业务的可持续发展奠定坚实的基础。公司晶圆代工成本今年二季度相对稳定，三季度以来成本略有下降，且公司目前的在手订单充沛。自上市以来，公司经营持续获得新的动力，公司将积极深耕主营业务，继续发展汽车电子、边缘计算和服务器存储控制等重点业务，努力提升核心竞争力，持续推出新产品，加大市场的开拓力度，加强在手订单执行工作，努力实现更好的业绩，从而更好地回馈广大投资者。谢谢！

**9、三季度晶圆代工价格情况，有下降吗？**

答：尊敬的投资者，您好！总体而言，公司三季度晶圆代工价格和上半年相比略有下降。谢谢！

**10、肖总好，请问公司在 AI 领域的布局情况如何？**

答：尊敬的投资者，您好！在高性能计算和 AI 领域，国芯科技已经开发了面向高性能运算的 64 位 CRV-7 CPU 内核，该处理器对标国外的 Cortex-A55，其性能超越 A55，且带有全国产化的生态和开发环境。基于 RISC-V 指令架构的神经网络扩展指令集架构研究，作为在 RISC-V 处理器上运行的扩展自定义指令，形成神经网络处理器专用指令集，能够支持神经网络算法的加速处理，并用于 CRV4AI 和 CRV7AI 处理器的实现中。公司已在生物特征识别领域推出了包括轻量级 AI（卷积协处理器）的 SoC 芯片，实现指纹和人脸识别应用，未来公司将在现有基础上继续发展生物特征识别领域的高性能 AI 芯片。同时，

公司正在推进量产的 Raid 芯片在 AI 服务器中有广泛应用。在高性能计算和 AI 领域芯片定制服务方面，公司目前已有多个高性能计算和 AI 芯片定制服务的在手订单。截至 2023 年 6 月 30 日，高性能（边缘）计算和人工智能业务的在手订单为 4.13 亿元。谢谢！

**11、请问公司有考虑如并购 GPU 企业等措施？加快 AI 芯片的研发与市场拓展步伐吗？为算力及 AI 国产替代作贡献！**

答：尊敬的投资者，您好！公司暂未考虑并购 GPU 公司，但公司正在和参股公司智绘微电子合作，联合投资和开发 GPU 芯片，公司主要从事后端设计和流片工作，该 GPU 芯片已完成设计，目前正在流片验证中，未来将以国芯科技和智绘微双品牌进行市场销售。同时公司和上海清华国际创新中心、智绘微电子合作开发基于开源 RISC-V 架构的 GPGPU 内核，为公司未来发展打下技术基础。公司已经与昆仑芯（北京）科技有限公司已经签署《战略合作框架协议》，双方将针对智能驾驶场景，展开在边缘 AI 计算、车规功能安全 SoC 等技术领域的长期合作，充分整合双方资源，实现优势互补，协同提升技术竞争力，共同开拓更加广阔的智能驾驶市场。

在高性能计算和 AI 领域，国芯科技已经开发了面向高性能运算的 64 位 CRV-7;CPU 内核，该处理器对标国外的 Cortex-A55，其性能超越 A55，且带有全国产化的生态和开发环境。基于 RISC-V 指令架构的神经网络扩展指令集架构研究，作为在 RISC-V 处理器上运行的扩展自定义指令，形成神经网络处理器专用指令集，能够支持神经网络算法的加速处理，并用于 CRV4AI 和 CRV7AI 处理器的实现中。公司已在生物特征识别领域推出了包括轻量级 AI（卷积协处理器）的 SoC 芯片，实现指纹和人脸识别应用，未来公司将在现有基础上继续发展生物特征识别领域的高性能 AI 芯片。同时，公司正在推进量产的 Raid 芯片在 AI 服务器中有广泛应用。在高性能计算和 AI 领域芯片定制服务方面，公司目前已有多个高性能计算和 AI 芯片定制服务的在手订单。截至 2023 年 6 月 30 日，高性能（边缘）计算和人工智能业务的在手订单为 4.13 亿元。谢谢！

**12、公司入股价已跌破发行价？公司除原有回购措施外？还有哪些举措扭转？真真切切的回报投资者**

	<p>答：公司股价近期波动受二级市场行情等多种因素综合所致，公司经营管理一切正常并持续向好，公司的投资价值未发生重大变化。公司目前的在手订单充沛，正在实施回购股份事项。自上市以来，公司经营持续获得新的动力，公司将积极深耕主营业务，继续发展汽车电子、边缘计算和服务器存储控制等重点业务，努力提升核心竞争力，持续推出新产品，加大市场的开拓力度，加强在手订单执行工作，致力于推进嵌入式 CPU 的国产替代，努力实现更好的业绩，从而更好地回馈广大投资者。</p> <p><b>13、三季度有新获得汽车电子订单吗？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司三季度有获得新的汽车电子订单。谢谢！</p> <p><b>14、请问二代 RAID 预计什么研发完成？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！二代 RAID 芯片预计在今年四季度完成设计进行投片验证。谢谢！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 9 月